

半導體封裝與技術，輔修(21學分)

MSE-U-PN-002

配當年：114學年度

學程描述：

針對半導體封裝 (Semiconductor Packaging) 技術之發展、原理與應用進行系統性介紹。透過理論課程、案例分析與產業技術趨勢導讀，使學生具備完整的封裝技術知識，並理解其在半導體供應鏈中的關鍵角色。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
必修	MSE1000	材料科學導論(一)	3	
必修	MSE2000	材料熱力學(一)	3	
必修	MSE2001	物理冶金學(一)	3	
選修	MSE3060	半導體製程技術	3	
選修	MSE4030	半導體材料	3	
選修	MSE4073	三維積體封裝技術	3	
選修	MSE4092	功率半導體封裝技術	3	

取得資格總學分： 21

必修學分數： 9

選修學分數： 12

管理單位：工程與科學學院 / 材料科學與工程學系